

◇ ◇ 国 際 会 議 ◇ ◇

(※は参加費割引あり)

2020 International Conference on Electronics Packaging (ICEP2020)

期 日 2020年4月22日(水)～25日(土)

会 場 日本科学未来館(東京都江東区)

問合先 同国際会議事務局

TEL [03] 5657-0789, FAX [03] 3452-8552

icep2020-reg@jtbcom.co.jp <http://www.jiep.or.jp/icep/>

炭素材料国際会議 (CARBON2020)

期 日 2020年6月28日(日)～7月3日(金)

会 場 みやこめっせ(京都市)

問合先 炭素材料学会 CARBON2020 組織委員会担当 深津

TEL [03] 6824-9376, TEL [03] 5227-8631

carbon2020@bunken.co.jp <http://www.tanso.org/carbon2020/>